

证券代码：603061

证券简称：金海通

天津金海通半导体设备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-011

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场访谈 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 线上分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 线上调研
参与单位名称	泰康基金、汇丰晋信、长信基金、申万菱信、国泰基金（以上排名不分先后） 业绩说明会：参与业绩说明会的投资者	
时间	2024年8月6日至2024年8月8日	
地点	线上调研：腾讯会议 路演：上海市黄浦区中山南路100号、上海市虹口区公平路18号 业绩说明会：上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ）	
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书刘海龙先生	
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司介绍主要内容</p> <p>金海通的主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售，客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。公司产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、欧美、东南亚等全球市场。</p> <p>公司自成立以来，始终坚持深耕集成电路测试分选机的研发、生产和销售。公司深耕平移式测试分选机领域，产品根据可测试工位、</p>	

测试环境等测试分选需求分为 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列、EXCEED-9000 系列、SUMMIT 系列、COLLIE 系列、NEOCEED 系列等。

公司的核心技术集中于“高速运动姿态自适应控制技术”、“高兼容性上下料技术”、“高精度温控技术”、“芯片全周期流程监控技术”等领域。公司产品的软件定制化程度高，集成程度高，反馈速度快，技术支持响应度好；产品的 UPH（单位小时产出）、Jam rate（故障停机率）、可并行测试最大工位等指标已达到同类产品的国际先进水平。

二、公司 2024 年上半年业绩情况介绍

2024 年上半年，半导体行业下游景气度边际复苏，半导体封装和测试设备领域呈现弱复苏状态，公司实现营业收入 1.83 亿元，较 2023 年上半年同比下降 1.65%，较 2023 年下半年环比增长 13.73%；受销售费用等费用同比增长等因素影响，公司实现净利润 3967.68 万元，较 2023 年上半年同比下降 11.75%，较 2023 年下半年环比下降 0.40%。

产品方面，2024 年上半年，公司现有产品新增 PD（局部放电）测试、串测、Near short（接近短路）测试等测试分选功能。在新品方面，2024 年上半年 EXCEED-9800 系列三温测试分选机实现量产，公司正积极推进此系列产品的销售。同时，公司也推出了适用于 MEMS 的测试分选平台，目前已在客户现场进行产品验证。后续公司也会视情况推出适用 Memory、碳化硅及 IGBT、专用于先进封装产品的测试分选平台。公司持续跟进客户需求，不断对现有产品在温度控制、并测工位、芯片尺寸、上下料方式和压力控制等各方面进行技术研发和产品迭代。

公司募投项目“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”目前处于土建工程建设阶段。本项目建设周期 3 年，建成后将进一步增加公司研发及制造等综合竞争力。

市场推广方面，2024 年上半年，公司加大全球市场开拓力度，与客户保持紧密沟通，积极参加展会等行业相关活动。同时，公司持续提升自身的客户服务能力，加强境内、境外销售及售后团队管理，以提高客户服务效率，完善客户服务体系。公司 2024 年上半年销售费用较上年同期增长 30.6%，主要系销售人员工资、海外代理费用及售后费用的增长所致。2023 年 6 月，公司启动“马来西亚生产运营中心”项目，该项目拟建立在东南亚地区具有全面服务客户的生产和应用能力

的生产运营基地，从而更好地贴近市场和客户、响应客户需求，促进公司稳健经营和持续发展。截至目前，“马来西亚生产运营中心”项目正处于厂房装修阶段。

对外投资方面，公司已参股投资了1家半导体晶圆级分选封测和平板级封装贴晶机设备及方案提供商——深圳市华芯智能装备有限公司，该公司主要产品为：晶圆级分选机 Wafer to tape&reel（晶圆到卷带）、IGBT KGD（已知良好芯片）分选机。

截至2024年6月末，公司总资产为15亿元，较上年末下降5.39%；净资产为12.63亿元，较上年末下降9.73%。总资产、净资产同比有一定下降系公司于2024年1月——4月使用1.66亿元通过集中竞价交易方式回购本公司股票242.4万股所致。

三、调研问答

1、问：目前看，订单能见度以及交货周期如何？

答：和之前差不多，一般情况下，客户会与公司进行持续性的常态化沟通，对公司产品的技术指标及交货周期等进行了解。对于量产机型及标准选配功能，公司具有快速交货能力。基于这种情况，客户通常会在需求相对确定时下单。

2、问：公司产品研发是如何规划的？

答：一方面，公司持续升级现有产品，持续跟进客户需求，不断对现有产品在温度控制、并测工位、芯片尺寸、上下料方式和压力控制等各方面进行技术研发和产品迭代；另一方面，公司也积极布局新产品，公司此前推出的EXCEED-9000系列产品是在EXCEED-6000、EXCEED-8000系列基础上对整个平台的升级，其中的EXCEED-9800系列是针对三温测试需求的升级产品。

2024年上半年，公司现有产品新增PD（局部放电）测试、串测、Near short（接近短路）测试等测试分选功能。在新品方面，2024年上半年EXCEED-9800系列三温测试分选机实现量产，公司正积极推进此系列产品的销售。同时，公司也推出了适用于MEMS的测试分选平台，目前已在客户现场进行产品验证。后续公司也会视情况推出适用Memory、碳化硅及IGBT、专用于先进封装产品的测试分选平台。同时，

公司也将积极布局重点关注的技术方向,截至目前公司已参股投资了 1 家半导体晶圆级分选封测和平板级封装贴晶机设备及方案提供商。

3、问：公司对于深圳市华芯智能装备有限公司的未来发展有何展望呢？

答：深圳市华芯智能装备有限公司是一家半导体晶圆级分选封测和平板级封装贴晶机设备及方案提供商，当前国内能够提供该方案的公司还比较少，加之其产品的单价和毛利水平比较高，因此公司对于其发展前景较为看好。但是其营收水平还不太能够预测，具体还看其在未来的经营发展情况。

4、问：据我们现在看，国内封测厂扩产用国产产品的意愿高吗？

答：公司受益于国内半导体行业的快速发展。

公司所在行业是充分国际化竞争的行业。公司自成立以来，一直以国际市场需求为导向，坚持“国际化定位”，以技术创新为动力，以成为“全球测试分选行业领先者”为目标，这一定位将在未来长期坚持。

公司目前在马来西亚、新加坡等地设有境外经营主体或办公室等。在国际化市场战略的背景下，公司境内经营主体协同境外经营主体或办公室面向半导体产业发达的国家和地区进行持续性、常态化的市场开拓及售后服务。2023 年 6 月，公司启动“马来西亚生产运营中心”项目，该项目拟建立在东南亚地区具有全面服务客户的生产应用能力生产运营基地，从而更好地贴近市场和客户、响应客户需求，促进公司稳健经营和持续发展。截至目前，“马来西亚生产运营中心”项目正处于厂房装修阶段。

四、业绩说明会问答

1、问：请问最近利润下滑是什么原因？如何看待行业下半年趋势？

答：尊敬的投资者，您好！2024 年上半年，金海通实现营业收入 1.83 亿元，较 2023 年上半年同比下降 1.65%，较 2023 年下半年环比增长 13.73%；实现净利润 3967.68 万元，较 2023 年上半年同比下降

11.75%，较2023年下半年环比下降0.40%。2024年上半年，公司净利润同比下滑的原因主要系公司持续加大市场开拓力度，销售费用、管理费用等费用的增长。

公司将继续保持以技术为核心的策略，进一步扩大现有市场，依靠自身技术优势，针对客户的定制化需求，提供更优质的服务，逐步形成品牌效应，获得新的发展。在积极开拓境内市场的同时，公司将重点跟进境外头部IDM、OSAT以及设计公司等头部企业快速迭代的产品及测试分选需求。

感谢您的关注！

2、问：今年的行业情况怎么看，公司如何应对？

答：尊敬的投资者，您好！2024年上半年，半导体行业下游景气度边际复苏，半导体封装和测试设备领域呈现弱复苏状态。受国际贸易格局变化影响，全球半导体产业链正在经历产能布局的调整。半导体产业产能布局的调整及技术升级补缺已经在一定程度上开始促进半导体行业对封装和测试设备的需求复苏。与此同时，新能源、电动汽车及AI运算等相关产业的发展以及国家产业政策的支持也在一定程度上助推半导体封装测试设备领域的发展。

公司自成立以来一直深耕集成电路测试分选设备领域，公司主要为半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等提供自动化测试设备中的测试分选机及相关定制化设备。公司将积极、努力做好主营业务，持续进行研发创新和技术升级，提升公司的竞争力，在积极开拓境内市场的同时，公司将重点跟进境外头部IDM、OSAT以及设计公司等头部企业快速迭代的产品及测试分选需求，更好地服务客户和回报投资者。

感谢您的关注！

3、问：请问公司在国内行业地位如何？同类上市公司有哪几家？

答：尊敬的投资者，您好！公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售。集成电路测试分选机属于集成电路专用设备领域的测试设备。公司自成立以来深耕集成电路测试分选机领域，经过

	<p>多年的研发和创新，公司产品的技术指标及功能已达到同类产品国际先进水平。</p> <p>公司所在行业是充分竞争的全球化市场。目前，全球集成电路测试分选机行业内，除公司外，上市公司主要有美国科休半导体公司（Cohu, INC.）、日本精工爱普生公司（Seiko Epson Corporation）、日本爱德万测试集团（Advantest Corporation）、杭州长川科技股份有限公司等企业。其中，杭州长川科技股份有限公司是 A 股上市公司。</p> <p>感谢您的关注！</p> <p>4、问：请问在目前地缘政治环境下，公司是否存在受制裁的风险？是否已采取相关应对措施？谢谢！</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售。集成电路测试分选机属于集成电路专用设备领域的测试设备，公司所在行业是充分竞争的全球化市场。公司在境外业务布局过程中会持续关注和全面评估各类商业或非商业风险，综合运用多种措施为公司境外业务的合规及稳健运营提供保障。目前公司境外相关业务均有序开展。</p> <p>感谢您的关注！</p>
附件清单 (如有)	无
风险提示	以上如涉及公司所处行业发展趋势、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业发展、公司发展或业绩的预测和承诺，不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2024 年 8 月 8 日